

NEW

简单就好



型 号 6500

自动化，高精度 贴片系统

MAT 6500型贴片系统用于环氧树脂、共晶、C2/C4、超声波、ACF/ACP、银玻璃、UV粘合剂、银烧结等面向上及倒装芯片应用。

所有工艺功能均内置，通过简单地启用或禁用某个参数切换。在Windows®下运行多功能、用户友好的图形界面，几秒钟内即可切换。

上述应用需要的所有硬件都为即插即用。6500 型是全自动系统，但留有一个大工作区和可选的手动材料装/卸区，便于操作。

对于多芯片模块、射频、混合应用，可处理从150 μm 直到几乎任何尺寸的组件：

- 多达40个网格板/凝胶包
- 多达8个磁带和卷轴馈线
- 300 mm晶圆

热敏或UV胶由：

- 体积、时间-压力或喷射点胶机，可用于库里的各种复杂形状
- 下冲（引脚转换）胶点直径 75 μm

自动工具更换站处理多达12个不同的平面拾取工具，锥体芯片夹套和冲压工具。

主轴伺服系统确保了极高的放置精度，高分辨率数字视觉确保系统可用于要求高达3 μm 精度的应用场景。



该设备具有独特的粘合层厚度（BLT）控制能力，适用于银玻璃、MEMS和湿片堆叠应用。

- 可编程的 BLT
- 由高度测量实现的BLT控制
- 可编程的粘合力与触地速度
- 极高的BLT精度，不受粘合剂体积变化的影响。
- 优于5 μm BLT 精度。



型号 6500

贴片系统

无与伦比的多功能性

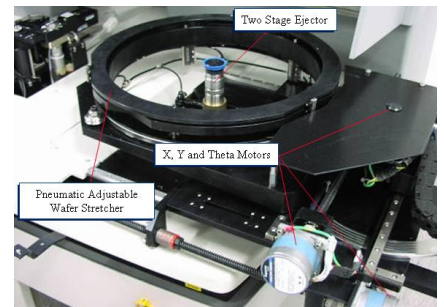


全倒装芯片工艺能力，包括芯片翻转、凹凸磁通和芯片精确对准高分辨率的仰视相机。设备可进行冷热加工，包括：

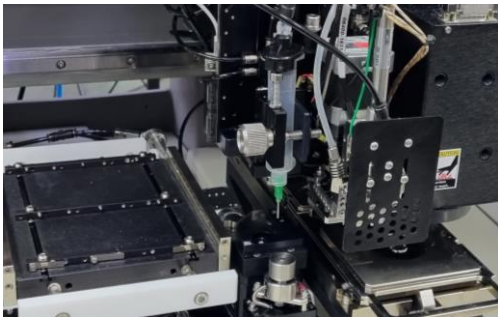
- C2、C4或类似的冷、热工艺进行预粘接
- 使用热声波工艺，频率高达130千赫，功率高达40瓦的金-金互连（GGI）。
- 热压缩高达90 N和500°C
- 上述组件的底部填充。

独有的2阶段芯片弹出系统，可以从晶圆切片中，从蓝色或紫外线胶带挑选较大和较薄的芯片：

- 高达300 mm晶圆
- 内置胶带拉伸系统
- 薄片性能低至50 μm
- 芯片尺寸从150 μm 到50 mm以上。
- 超乎寻常的芯片长径比能力
- 电子晶圆图和/或墨点检测。



加热应用高达500°C的不同共晶工艺，包括AuSn、AuGe、AuSi和其他互连材料。



- 由于芯片独特的局部加热，可执行共晶MCM 应用。
- 在室温下从凝胶包装、晶圆或网格板包装中挑选组件。
- 可编程的刀具加热时间和快速冷却。在回流过程中提供热成型气体。
- 擦洗与可编程的形状、振幅和速度。
- 基材预热和气罩。
- 使用锥体芯片夹头和平面拾取工具的预制件。

规格参数

工作区：最大20×6英寸

芯片尺寸：0.006 英寸至 2 英寸以上

芯片材质：砷化镓、硅、玻璃等。

基板：引线框架、陶瓷、硅片、PCB、金属、激光二极管模块等。

拾取/粘合力：40至9000克。

深度：50mm Z行程。

放置精度：优于 $\pm 3 \mu\text{m}$ ——取决于应用。

产量：高达1000 CPH ——取决于应用。

面积：1.2平方米。

重量：350kg。

